

<<机电一体化系统设计>>

图书基本信息

书名：<<机电一体化系统设计>>

13位ISBN编号：9787111171645

10位ISBN编号：7111171640

出版时间：2005-1

出版时间：机械工业出版社

作者：[美] 谢提（Shetty, D.）；张

页数：336

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<机电一体化系统设计>>

### 内容概要

本书将机电一体化相关的内容综合为一体，系统介绍机电一体化系统的设计过程。

主要涵盖机电一体化系统的建模和仿真，传感器的基本理论和操作原理，软硬件要求、控制和设计，以及计算机接口和实时数据采集与控制的理论的实践应用等。

包含大量可以用实验室环境迅速组装并试验的研究实例、问题和案例分析，通过系统建模技术将复杂分散的内容用清晰简洁的方式融合起来。

章后包含种类习题，方便教学。

本书适合作为机械工程、电子工程和机械电子工程等专业高年级本科生或研究生的教材，同时也可供相关工程技术人员参考。

## <<机电一体化系统设计>>

### 作者简介

Devdas Shetty，美国康涅狄格州哈特福德大学的制造工程终身教授，哈特福德大学工程学院副院长和工程应用中心主任。

他在机电一体化设计领域的研究成果举世瞩目。

## <<机电一体化系统设计>>

### 书籍目录

译者序前言第1章 绪论 1.1 什么是机电一体化 1.2 机电一体化集成设计问题 1.3 机电一体化关键要素  
1.4 机电一体化设计过程 1.5 机电一体化中的高级方法 1.6 小结第2章 物理系统的建模和仿真 2.1 概述  
2.2 仿真和框图 2.3 模拟和阻抗框图 2.4 电气系统 2.5 机械平动系统 2.6 机械转动系统 2.7 机电耦合 2.8  
流体系统 2.9 小结第3章 传感器和变换器 3.1 传感器和变换器概述 3.2 运动和位置测量传感器 3.3 力、  
转矩和触觉传感器 3.4 流量传感器 3.5 温度传感器 3.6 超声波传感器 3.7 测距传感器 3.8 基于磁致伸缩  
式传感器的有源振动控制 3.9 机电一体化系统中的光纤器件 3.10 小结第4章 执行装置第5章 机电一体化  
系统的硬件组成第6章 信号、系统与控制第7章 实时接口第8章 机电一体化系统的高级应用第9章 案例  
分析附录 国内外电气图形符号对照索引

<<机电一体化系统设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>